



*a Leiterplattenlayout
 printed circuit board layout
 modèle de la carte imprimée

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2411 03	4	100

Verpackung: im Tablett
 Packaging: in tray
 Emballage: en tableau

2411 03

USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

1. Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PBT
Kontaktfeder	CuSn
Lötanschluss	CuSn
Gehäuse	CuZn/Stahl
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	≤ 35 N
Ziehkraft	≥ 10 N
Kontaktierung mit	USB-Stecker 2431
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	≤ 1 A
Bemessungsspannung	30 V AC (RMS)
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

2411 03

USB 2.0 chassis socket type B, angular version, for printed circuit boards

1. Temperature range	-40 °C/+85 °C
2. Materials	
Insulating body	PBT
Contact spring	CuSn
Solder pin	CuSn
Shell	CuZn/steel
3. Mechanical data	
Insertion force	≤ 35 N
Withdrawal force	≥ 10 N
Mating with	USB plug 2431
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	≤ 1 A
Rated voltage	30 V AC (RMS)
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

2411 03

Embase femelle USB 2.0 type B, version angulaire, pour cartes imprimées

1. Température d'utilisation	-40 °C/+85 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PBT
Ressort de contact	CuSn
Plot à souder	CuSn
Boîtier	CuZn/acier
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	≤ 35 N
Force de séparation	≥ 10 N
Raccordement avec	connecteur mâle USB 2431
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	≤ 1 A
Tension assignée	30 V AC (RMS)
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ